



電気 UV3D プリンティング向け設計のヒント

- 推奨ファイル形式：ガーバーファイルを PDF に変換したもの。
- 最小配線幅：100 ミクロン。
- 最小間隔：端から端まで 200 ミクロン。
- 配線間の間隔だけでなく、配線とドリル穴／ビア間の間隔にも十分注意してください。
 - 推奨間隔：約 200 ミクロン、配線端からビア壁まで。
 - ビアに近すぎる配線は、導電性インクが意図せずビアを透過してしまう可能性があり、層間短絡を引き起こす恐れがある。
- ドリル穴が印刷される。これは基本的に、標準的なドリル穴ファイルの反転画像を印刷することで、層内にビアとして機能する空隙を残すというものである。
 - 最小ビアサイズ：直径 200 ミクロン。
- ソルダーマスク 絶縁層と同じ誘電体材料を用いて印刷することができる。
- 外部基準点は、位置合わせにおいて非常に役立ちます。
 - ソフトウェア内および実際のビルド全体を通して、レイヤー間の位置合わせを容易にするため、すべてのレイヤーで一貫した外部基準点を少なくとも **1** つ使用することを強くお勧めします
- 可能であれば、銀インクの消費量を削減するために、ハッチングされた地平面を用いるのも一つの方法です。
- 部品を取り付けるパッドの場合：
 - はんだ付けのためのしっかりとした土台を作るため、銀の層を追加で印刷することをお勧めします。
 - これらの繰り返しパッド積層層については、はんだ付けされるパッドのみを含む別のファイルを使用することをお勧めします。パッドは、積層中に発生する可能性のある広がり considering、約 **20%** 縮小されます。
- 電源配線の場合：
 - 部品取り付け用のパッドと同じ概念で、電源配線のみを含む別ファイルを、設計仕様を満たすために必要に応じて繰り返し印刷することができる。
- 一般的な基質に関する推奨事項：
 - 最も一般的なもの：カプトン/ポリイミド、FR4 ボード、PET（ポリエチレンテレフタレート）
 - 剛性または柔軟性に関わらず、あらゆる平面。
 - 接着に問題がある場合は、誘電体ベース層を印刷するか、当社のワイプオンプライマーを使用して接着性を向上させてください。
- 基本的なファイル/デザイン操作は、フロントエンドのプリンターソフトウェアの機能を使用して行うことができ、次のようなデザイン要素を迅速に変更できます。
 - ビアの拡張／縮小。
 - 線を太くする／細くする。
 - 基本情報を追加／削除します。



PHONE: +1 646-775-4976

EMAIL: info@3dworldtech.com

WEBSITE: chemcubed.com

©2024 ChemCubed, LLC All rights reserved. All specifications subject to change at any time without notice.
Please consult your sales representative for most current information.